北京工业大学 2012-2013 学年半导体物理期末试卷

一、 简答题(5*6'=30')

- 1. Si和 GaAs 半导体晶体的解理面分别是什么?为什么?一种半导体材料导带底 Ec(k)附近和价带顶 Ev(k)附近表达式为:
 - , 判断该半导体是直接带隙还是间接带隙。
- A、B 两种半导体, A 的禁带宽度为 1eV, B 的为 1.2eV, 其他各种参数均相同, 求 ni 之比
- 3. 什么是载流子的迁移率,影响因素,假定半导体内存在三种散射机制。只存在第一种散射机制时的迁移率是2000 cm²/Vs,只存在第二种散射机制时的迁移率是1500 cm²/Vs,只存在第三种散射机制时的迁移率是500 cm²/Vs,求总迁移率。
- 4. 什么是 PN 结的势垒电容?与平行电容板的区别,如何降低势垒电容?

区别:平行板电容器两极板间的距离 d 是一个是常数,不随电压 V 变化,而空间电荷宽度 Xm 不是一个常数,随电压 V 变化,因此其电容是常数。势垒电容是偏压 V 的函数,在一定的直流外加偏压下,当电压有微小变化时,相应的

5. 写出理想 PN 结电流-电压关于 (J-V) 公式。Pn 结与肖特基结电流成分的区别。

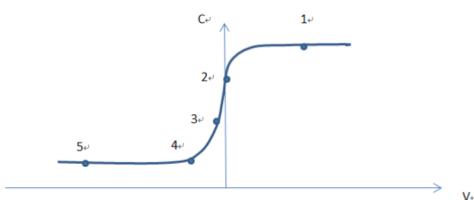
<u>肖特基二极管</u>内部是由阳极金属和阴极金属等构成,在 N 型<u>基片</u>和阳极金属之间形成<u>肖特基势垒</u>。 当在肖特基势垒两端加上正向偏压时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。

PN 结<u>二极管</u>是有<u>半导体材料</u>组成的,阳极是 P,阴极是 N,中间形成 PN 结,当加正向电压大于死区电压二极管导通

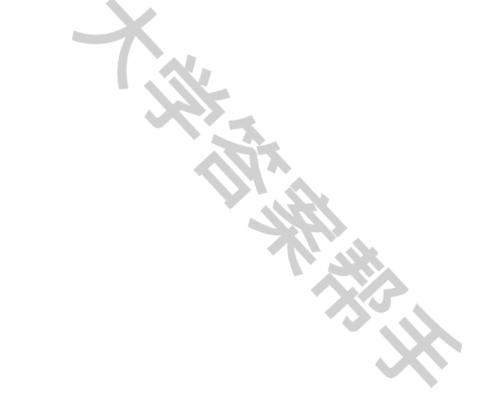
- 二、 (15')N型半导体,
- 1) 画 n-T 图 , 并解释
- 2) 画µ-T图
- 3) 由(1)(2)画ρ-T图,并解释
- **三、** (15′) ─理想的 MOS 结构的高频测量的 C-V 曲线如下图
- (1) 判断该结构中, 半导体的 n/p。
- (2) SiO2 层, C=200pF, S=2x10-3cm², 求 di

(3)说明图中 1,2,3,4,5 点的半导体一侧的状态,并示意画出每点半导体一侧的能带形状,以及金属和半导体一侧的电荷分布。

.

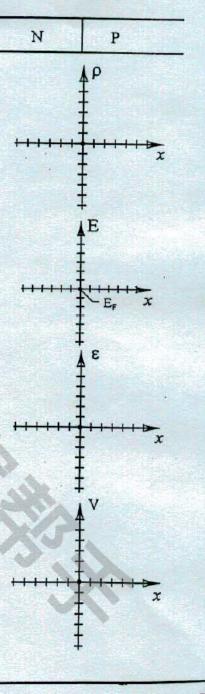


四、15′



五、 $(25 \, \text{分})$ pn 结二极管,其 N 型侧掺杂浓度 N_D 是 P 型侧掺杂浓度 N_A 的 5 倍 $(N_D = 5N_A)$,当处于热平衡态时,在耗尽层近似下,

- 4) 示意画出电荷密度 ρ 分布
 图 (ρ~x),假定纵轴 (ρ)
 上一个刻度等于 |qN_A|;
- 5) 示意画出简易能带图 (E ~ x), 假定纵轴 (E) 上一个刻度等于 Eg/4, 而且 P 型侧 E_F-E_V=E_g/4、n型侧 E_C-E_F=E_g/8;
- 6) 示意画出电场强度分布图(ε~x);
- 7)示意画出电势分布图 (V ~ x), 假定纵轴 (V) 上一个刻度等于 1/4 的 E_g/q;
- 8) 用 E_g 表达出此 pn 结的自建 电势 V_{bi} 的大小。



共3页第2页

9)要增大击穿电压,如何改变掺杂浓度?并画出能带图 E-X。

五、 (15') 室温下, 一块电阻率为 0.43Ω·cm 的 n 型硅

(1) 求多子浓度和少子浓度(可查图)。

- (2) 计算费米能级位置 Ec-Ef。
- (3)制备肖特基二极管,在W_{Au}=4.80eV,Wpt=5.3,W_{Ga}=4.0,Wcu=4.1,应选哪些金属?为什么?
- 4) 求 qVd 最大的金属和其 qVd,画出能带图。

六、 (10')肖特基实验,题中给出过程。

- 1) Δn 和Δp 的运动方向,为什么?
- 2) 如何测出迁移率,是多子还是少子?

附录:

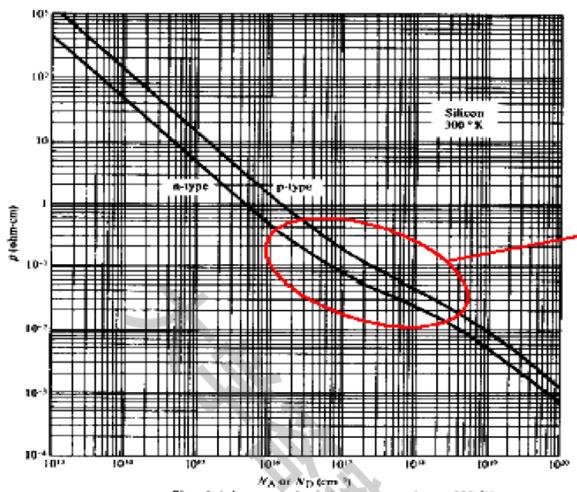
1. 物理常数:

电子电荷	Q	1.6x10 ⁻¹⁹ C
波尔兹曼常数	K	1.38x10 ⁻²³ J/K
电子伏特	eV	1.6x10 ⁻¹⁹ J
真空介电常数	ε ₀	8.854x10 ⁻¹² F/m

2. Si 材料的性质 (300K):

本征载流子浓度	ni	1.5x10 ¹⁰ cm ⁻³
导带底等效状态密度	Nc	3x10 ¹⁹ cm ⁻³
价带顶等效状态密度	Nv	1x10 ¹⁹ cm ⁻³
亲和势	Х	4.05eV
禁带宽度	Eg	1.12 eV

3. Si 材料电阻率随掺杂浓度变化图



Si resistivity versus impurity concentration at 300 °K.